

МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЛАТЫ НЧ, ВЧ И СВЧ ГИС

С-Компонент изготавливает микрополосковые платы ГИС НЧ, ВЧ и СВЧ-диапазона, помогая своим Заказчикам не только снижать себестоимость серийных изделий, но и реализовывать сложные проекты, требующие нестандартных технологических решений.

Подготовка подложек:

- Шлифовка, полировка
- Лазерное скрайбирование, резка, прошивка отверстий, контурная обработка
- Алмазная резка и профилирование

Магнетронное, ионно-плазменное и вакуумное термическое напыление:

- Проводящие слои Cu, Al и др. с подслоем Cr, V или Ti. Металлизация лицевой и экранной поверхностей, отверстий и торцов (в т.ч. селективная)
- Пленочные резисторы из кремниевых сплавов с абсолютно повторяемым ТКС

Прецизионная фотолитография:

- Мин. ширина проводника/зазор — 50 мкм
- Точность изготовления до +0/-5 мкм

Финишные операции:

- Функциональная лазерная подгонка и лазерная юстировка номиналов пленочных резисторов с точностью до 0,1%
- Нанесение гальванических покрытий
- Нанесение защитных покрытий
- Разделение групповых заготовок на платы

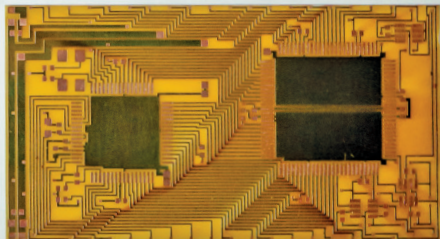
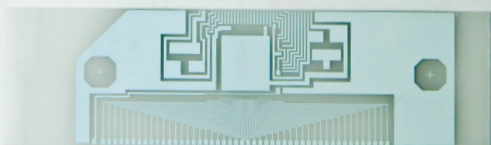
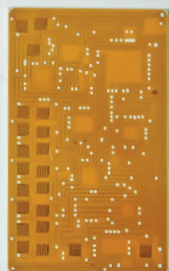
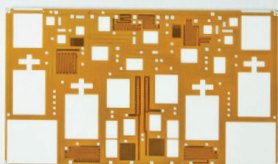
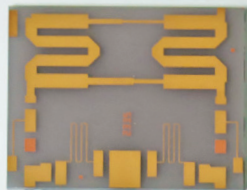
Дополнительно нашим предприятием разработана технология формирования прецизионных углублений в объеме керамической подложки для монтажа кристаллов СВЧ МИС:

- Высокая точность габаритов углубления (5 мкм)
- Возможность формирования стенок углублений с заданным углом наклона
- Максимальная точность посадки кристалла и копланарность его лицевой стороны с топологическим рисунком металлизации

Свяжитесь с нами для получения подробной информации и размещения заказа.

Мы отвечаем быстро.

Техническая информация представлена на обратной стороне.



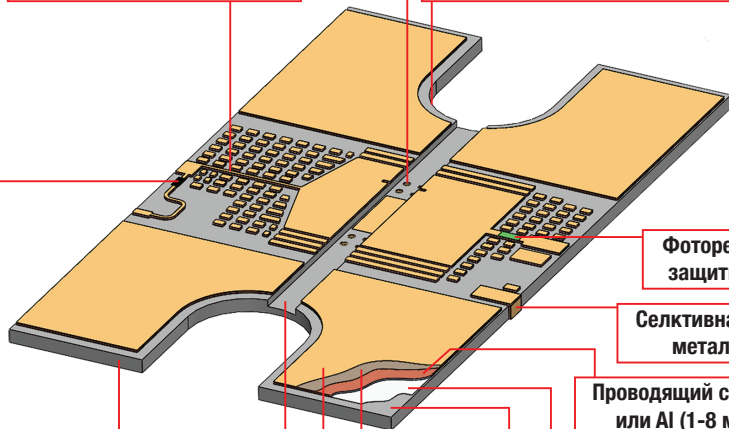
МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резисторы из кремниевых сплавов.
Подгонка с точностью до 0,1%

Ширина/зазор 50 мкм
с точностью до +0/-5 мкм

Переходные отверстия от \varnothing 0,1мм

Лазерная и алмазная обработка.
Пазы, слоты, монтажные отверстия и пр.



Фоторезистивные
защитные маски

Селективная торцевая
металлизация

Проводящий слой Cu
или Al (1-8 мкм)

Адгезионный подслой Cr, V
или Ti (100-200 Ом/кв)

Шлифованная и полированная
(до Ra = 0,005 мкм) поверхность

Барьерный слой Ni

Защитно-монтажный
слой Au (1-4 мкм)

Подложка BK-96,
BK-100, AlN или др.

Прецизионное углубление
для монтажа кристалла СВЧ МИС

Команда С-Компонент обеспечит незамедлительный ответ, предоставит развернутую техническую консультацию, поможет в выборе и предложит наиболее подходящий и экономичный вариант изготовления.

МЫ ПОМОЖЕМ!

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

+7 (495) 663-93-17
inform@c-component.ru
www.c-component.ru

 **С-КОМПОНЕНТ**

125476 Россия, г.Москва,
ул. Василия Петушкова, 8